

IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**PCB zásuvky pro jednopárový kabel Ethernet**

Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů.

Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.

Výhody jednopárového Ethernetu:

- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, SPE (Single Pair Ethernet), Nacvakávací příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 1.80 mm, Počet pólů: 2, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 2.1 mm, Ni/Au, Stříbrná, Tape
Objednací číslo	2795170000
Typ	IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL
GTIN (EAN)	4064675119265
Množství	100 ks
Balení	Tape

Datum vytvoření 8. května 2024 8:51:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	9,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,366 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	4,03 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Balení

Balení	Tape	Délka VPE	330 mm
Šířka VPE	330 mm	Výška VPE	29 mm

Specifikace systému

Boční ukončení, charakteristické	Nacvakávací příruba	Cykly zapojování	750
Kategorie	T1-B	Kategorie výkonu	T1-B 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
LED	Ne	Materiál stínění	CuSn
Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Plocha stínění	pocínované
Počet pólů	2	Proces pájení	Pájení přetavením, Manuální pájení, Pájení vlnou
Pájecí kolík, délka (l)	2,1 mm	Přenosová rychlost	10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Rozměry pájecích pinů	Osmiúhlý	Rozteč v mm (P)	1,8 mm
Rozteč v palcích (P)	0,071 "	Skupina produktů	Ethernet v průmyslovém prostředí
Stupeň krytí	IP20	Stínění	ano
Tažná síla / pól, max.	6,7 N	Tažná síla / pól, min.	3,4 N
Tolerance rozmístění pájecích pinů	± 0,1 mm	Typ připojení	Pájené připojení, Kontakt samec
Výstupní tvarovka	180°	Zásuvná síla / pól, max.	3,5 N
Zásuvná síla / pól, min.	9,1 N		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	2250 V DC
Izolační síla	≥ 500 MΩ	Jmenovité napětí	72 V
Jmenovitý proud	4 A	PoE / PoE+	PoDL podle IEEE 802.3bu / cg

Standardy

Standardní konektor	IEC 63171-2
---------------------	-------------

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	Stříbrná
Barevný graf (podobné)	RAL 7001	Izolační síla	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Contact base material	CuMg	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Ni/Au	Struktura vrstev pájeného připojení	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au
Provozní teplota, min.	-40 °C	Provozní teplota, max.	85 °C

Datum vytvoření 8. května 2024 8:51:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E316369

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	20221209 Änderung von SPE Typbezeichnung 20221209 Change of SPE type description
Technická dokumentace	IE-PCB-SPO-P-180V-THR 74678_IE-PCB-SPO-P-180V-THR_CD_20230606.pdf
Katalogy	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

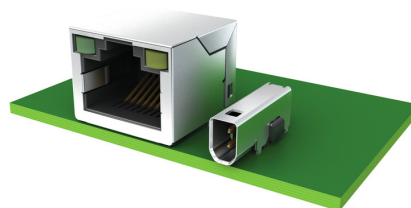
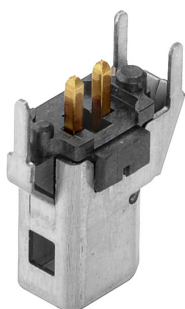
Klingenbergstraße 26

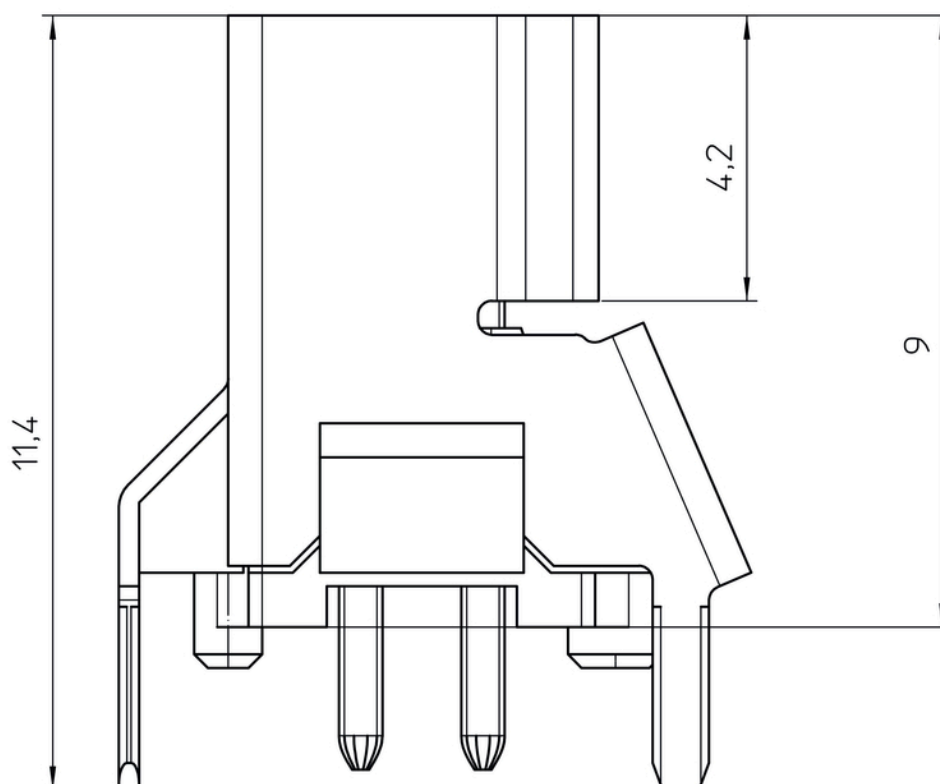
D-32758 Detmold

Germany

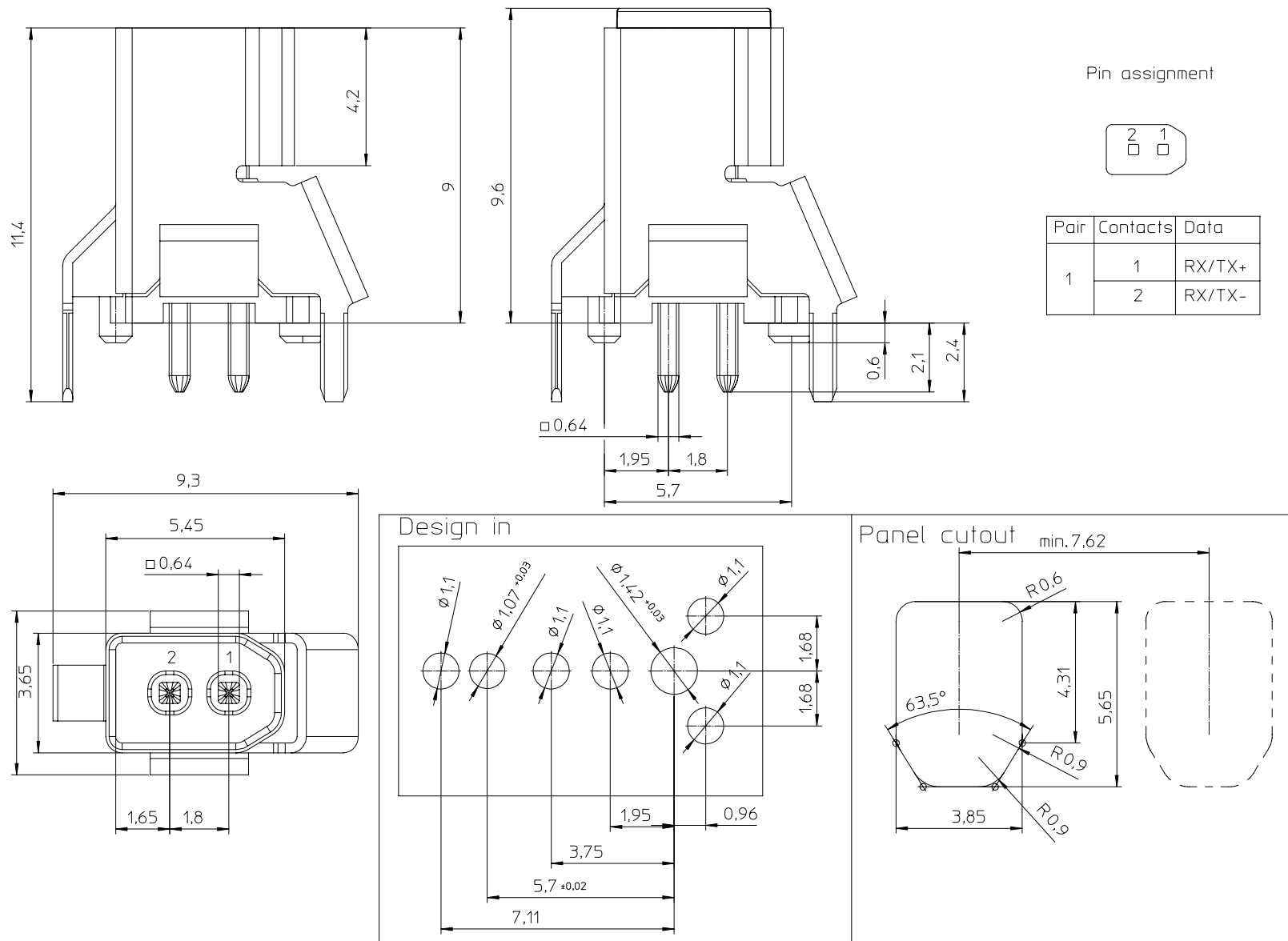
www.weidmueller.com

Nákresy

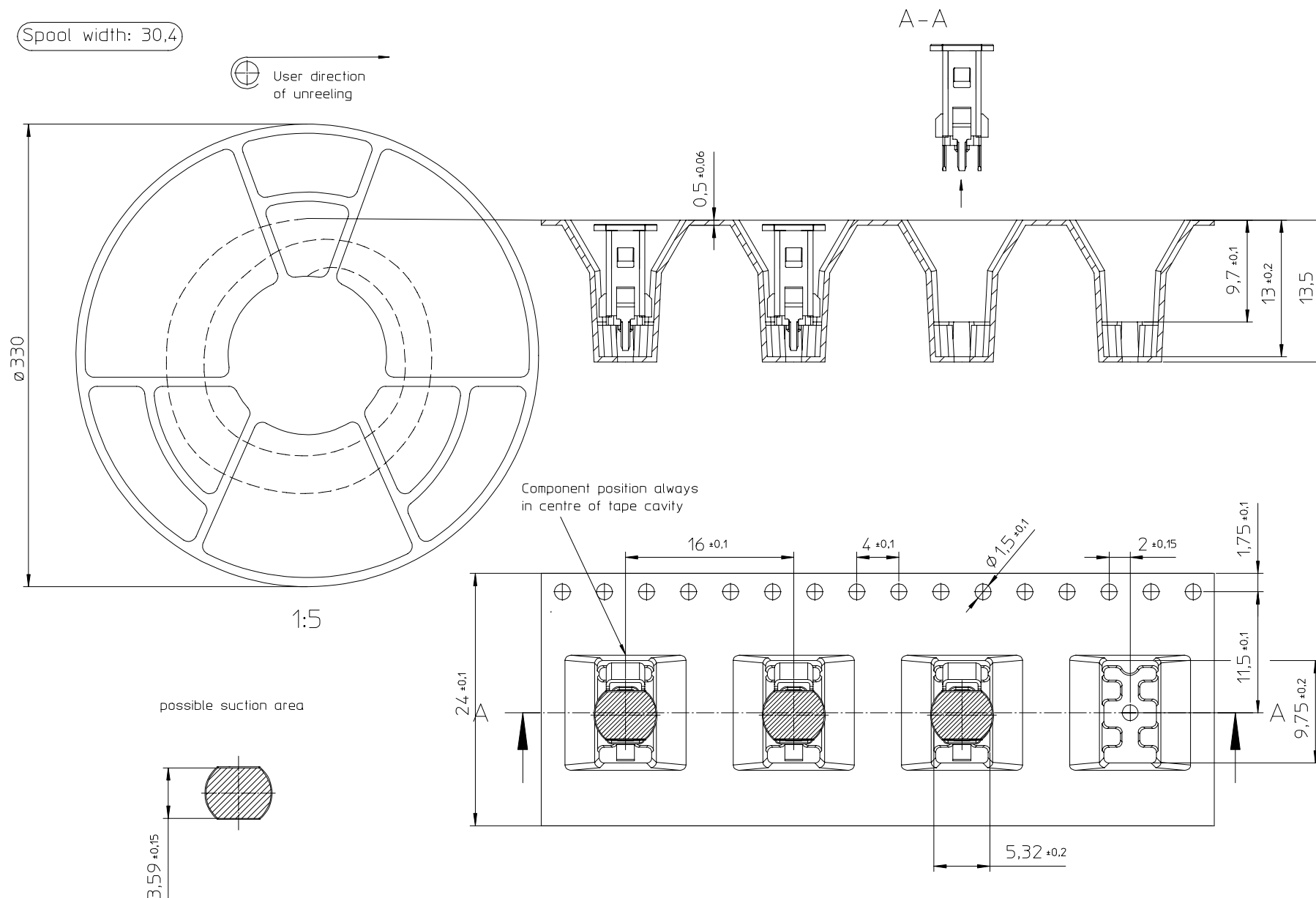




2795170000 IE-PCB-SP0-P-180V-THR



2795170000 IE-PCB-SP0-P-180V-THR



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.